

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）。士兰集昕为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年11月1日至2024年11月30日，公司在年度预计担保额度内为士兰集昕签署了担保金额为0.10亿元的最高额担保合同。

截至2024年11月30日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为9.38亿元，担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

- 上述担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2024年11月1日至2024年11月30日，公司在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：

担保合同名称	担保合同签署日期	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
最高额保证合同	2024年11月25日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	兴业银行股份有限公司杭州分行	担保的最高本金限额为人民币0.10亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生担保时，公司可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为70%以下的不同控股子公司相

互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计金额包含以前年度延续至 2024 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在公司 2024 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临 2024-026 和临 2024-038。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至 2024 年 11 月 30 日：

1、公司为士兰集昕提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为 9.38 亿元，担保余额在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为 19.86 亿元，剩余可用担保额度为 9.14 亿元，担保余额在公司 2023 年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）截至 2024 年 11 月 30 日，被担保人的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	本公司持股 比例 (%)		主营业务
						直接	间接	
杭州士兰集昕微电子有限公司	91330101MA27W6YC2A	2015 年 11 月 4 日	浙江杭州	陈向东	224,832.8735	47.73	32.35	芯片制造

（二）被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

项 目	2024年9月末/2024年1-9月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	346,692	364,046
负债总额	139,645	152,078
净资产	207,047	211,968
营业收入	104,673	144,071
净利润	-5,011	2,701

(三) 士兰集昕为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司杭州分行	担保的最高本金限额为人民币 0.10 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集昕日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集昕为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临 2024-026 和临 2024-038。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 48.066 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.98%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 39.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.15%；公司为厦门士兰集科电子有限公司提供的担保总额为 8.216 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年12月4日